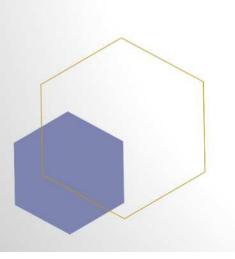


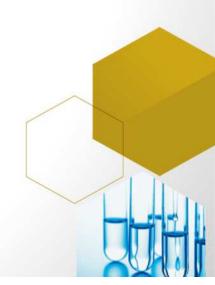
# 2023年3月期第2四半期決算説明資料

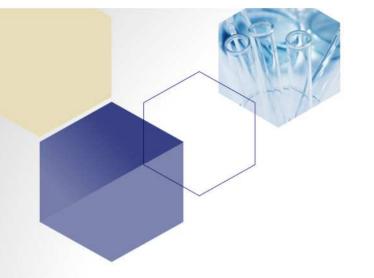
# **)** C 日本高純度化学株式会社

証券コード: 4973

2022年10月25日









# (注)当社業績の見方のポイント

- ▶売上高は、薬品と一緒に貴金属を売る場合と、売らない場合とで大きく変動します。
- →貴金属は、価格変動があり、かつ高価なため、売上高に 大きく影響します。

# 用語説明①(めっき方式)

用語	用途	説明
電解めっき (電気めっき)		金属などの表面に電気を流してめっきする方法
純金めっき	プリント基板 半導体搭載基板	高純度な純金めっき
硬質金めっき	コネクター プリント基板	合金成分を入れて硬くした合金めっき
パラジウム (Pd)めっき	リ <del>ー</del> ドフレーム コネクター	金めっきの下地めっきとして使用される PPFはPre Plated Lead frameの略
無電解めっき		電気を流さず化学反応によりめっきする方法
置換めっき	プリント基板	金属ごとの溶けやすさ(イオン化傾向)を利用し、下地金属の表面を置き換えて形成するめっき方法
還元めっき	プリント基板	還元剤による化学反応を利用し、厚く形成できる めっき方法



# 用語説明②(めっきプロセス)

用語	説明	めっき層構成
ENIG	銅上に無電解ニッケルめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Nickel Immersion Goldの略。 層構成はCu-Ni-Au	Ni Cu
ENEPIG	銅上に無電解ニッケルめっき、無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Goldの略。 層構成はCu-Ni-Pd-Au	Au Pd Ni Cu
DIG	銅上に置換金めっきを直接する方法。Direct Immersion Goldの略。Niめっきを省いているためENIGに 比べファインピッチ対応が可能。層構成はCu-Au	Cu
EPIG	銅上に無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Palladium Immersion Goldの略。 層構成はCu-Pd-Au	Au /-Pd Cu

# 製品ラインアップ ~ラインアップ拡充と新分野開拓~

		•	
	めっき方式	用途	製品ラインアップ
	純金		① 粗面上でも均一な膜厚が得られる純金めっき ② 硬度の高い純金めっき
電解	硬質金 (合金)		マイクロコネクター用省金硬質金めっき オーロブライト BAR7
	パラジウム(Pd)		PPF用薄膜パラジウムめっき パラブライト NANO2
	置換金		中~高リンニッケルで使える置換金めっき IM-GOLD IB2X 下地ニッケルの腐食が少ない置換金めっき IM-GOLD CN ニッケルめっきが不要な置換金めっき IM-GOLD PC
無電解	還元金	CRU	亜硫酸金を使った薄膜還元金めっき HY-GOLD シアン化金を使った薄膜還元金めっき HY-GOLD CN
	還元Pd		ENEPIG用還元パラジウムめっき ネオパラブライト 2 ダイレクト還元パラジウムめっき ネオパラブライト DP
	新分	野	卑金属(銅、スズ、ニッケル) 合金めっき 後処理剤など

# 2023年3月期 第2四半期決算概況

#### 電子部品業界の状況

- ●電子部品業界においては、クラウド/データセンタ向けや産業機器、工場、医療などのデジタルトランスフォーメーション(以下、DX)向けloTデバイス需要は比較的堅調に推移したが、これまで需要を牽引してきた5G対応スマートフォンやPCで在庫調整が見られ、減速感が出てきた。
- ●車載用電子部品については、自動車電装化に伴う最終製品1台あたりの電子部品や半導体搭載数増加による需要増に対して、中国のゼロコロナ政策によるロックダウンなどの影響により一部製品で供給不足を解消できず、自動車の生産調整が見られ回復が遅れた。

#### 当社決算の概況

- ●プリント基板・半導体搭載基板用めっき薬品の販売について、一部ブランドの5G対応スマートフォン向けで堅調に推移したが、中国及び韓国メーカーのスマートフォン向けやPC向け、メモリーのはで減産の影響を受け、販売が落ち込んだ。
- ●コネクター用めっき薬品の販売について、一部ブランドの5G対応スマートフォン向けや産業機器向けなどで堅調に推移したが、中国及び韓国メーカーのスマートフォン向けや車載向け減産の影響を補うには至らなかった。
- ●リードフレーム用めっき薬品の販売については、中国及び韓国メーカーのスマートフォン向けやパソコン向けの減産影響を受けたが、DX向けloTデバイスの需要に支えられ、微減に留まった。



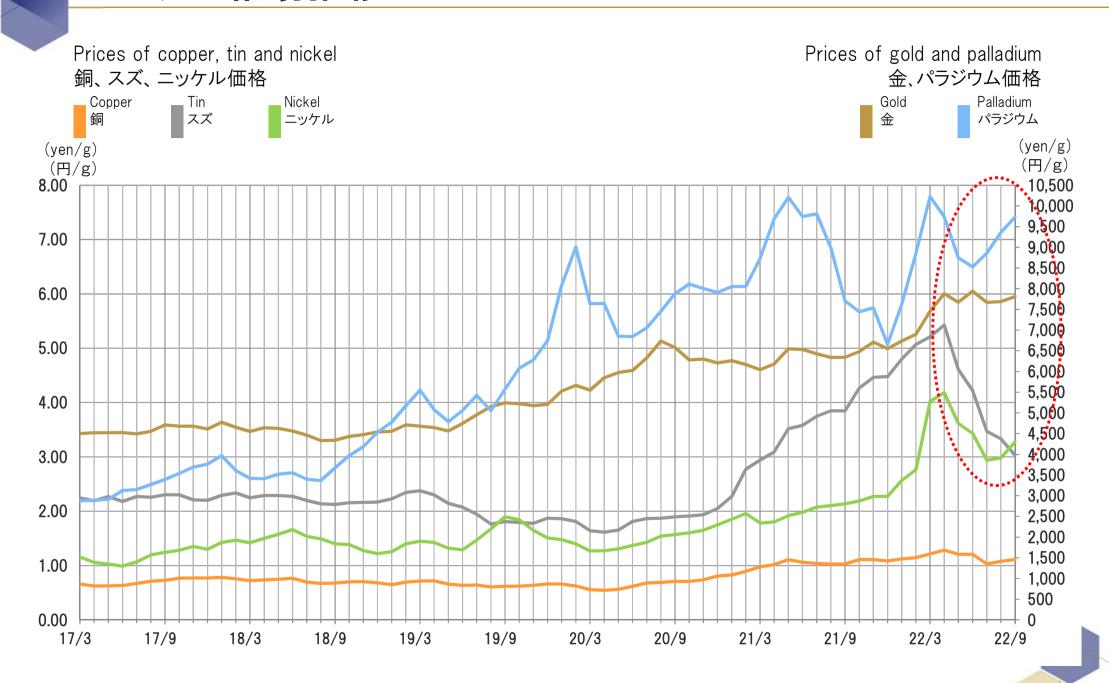
# 2023年3月期 第2四半期決算概況

(単位:百万円、%)

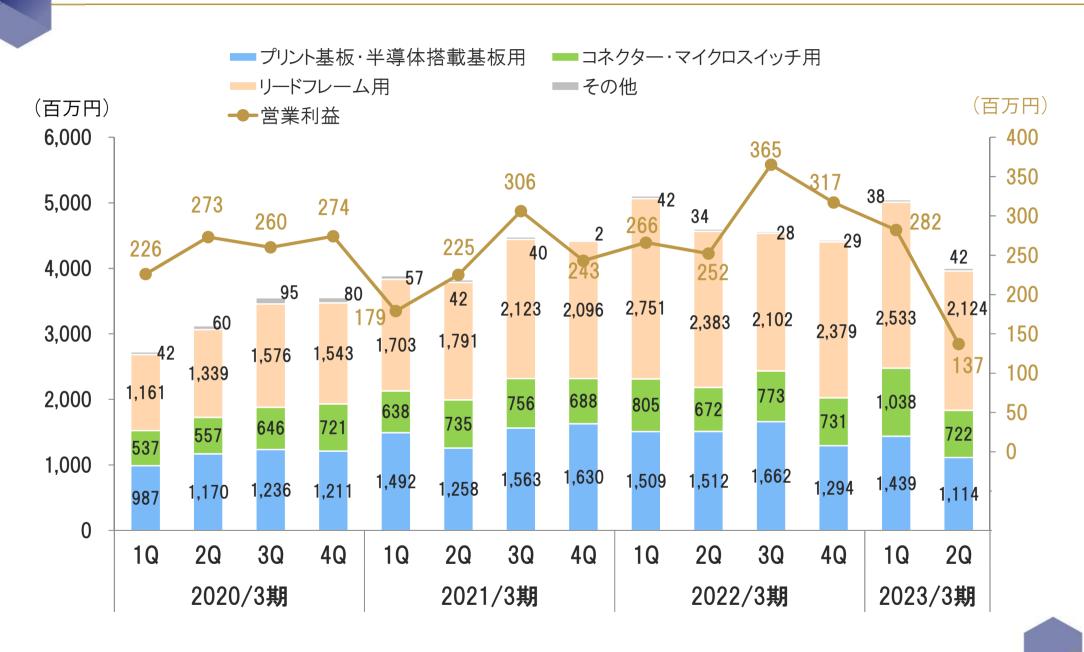
		2023/3期					
	2022/3期 1Q~2Q	1Q	2Q	1Q~2Q	増減率		
売 上 高	9,711	5,050	4,004	9,054	△6.8		
営 業 利 益	518	282	137	419	△19.1		
経 常 利 益	582	374	143	518	△11.0		
四半期純利益	426	278	102	380	△10.7		
1 株 当 た り四 半期 純 利 益	73.17円	47.52円	17.45円	64.93円	_		

●中国、韓国のスマートフォン、PC向けのプリント基板及びコネクターの 減産影響が大きく、前年同期比(上期)で売上高△7%、営業利益 △19%、経常利益△11%の減収減益となりました。

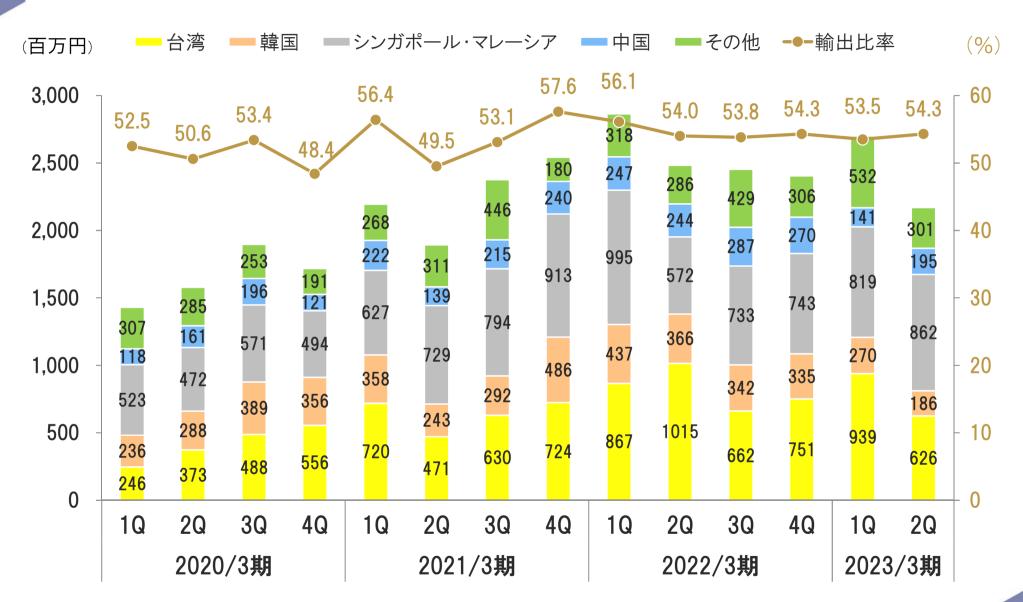
# メタル相場推移



# 売上高・営業利益の推移(四半期ベース)



# 輸出地域別売上高の推移(四半期ベース)





# 2023年3月期 通期の見通し

(単位:百万円、%)

				2023/3期				
			2022/3期	期初公表值	今回見込み (2022年10月)			
				(2022年4月)		構成比	前期比	4月比
売	上	高	18,714	20,000	18,500	100.0	Δ1.1	△7.5
営	業利	益	1,201	1,210	800	4.3	△33.4	△33.9
経	常利	益	1,339	1,350	950	5.1	△29.1	△29.6
当	期純利	益	974	975	680	3.7	△30.2	△30.3
配		当	90円	80円	80円			

- クラウド/データセンタ向け、自動車向けのプリント基板、コネクターの復調及び、産業、医療分野のDX(デッタルランスフォーメーション)進展に伴うloTデバイスの需要増はあるものの、スマートフォン、PCの需要回復遅れと在庫調整の影響は下期中も継続すると想定せざるを得ず、期初の見通しより減収減益となる見通し
- 配当については、期初公表値通り、年間80円(うち中間40円)とする

#### 株主還元策(2022年度)

#### 自己株式の取得及び消却

#### 取得及び消却の理由

●株主の皆様への利益還元の継続的な拡充、及び経営環境の変化に対応した機動的な 資本政策の遂行により、自己株式の取得及び消却を行います

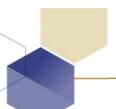
#### 取得の内容

(1)取得対象株式の種類当社普通株式	(1)
--------------------	-----

- (2)取得しうる株式の総数......120,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 2.04%)
- (3)株式の取得価格の総額......360百万円(上限)
- (4)取得期間......2022年10月26日 ~ 2023年3月31日
- (5)取得方法......東京証券取引所における市場買付

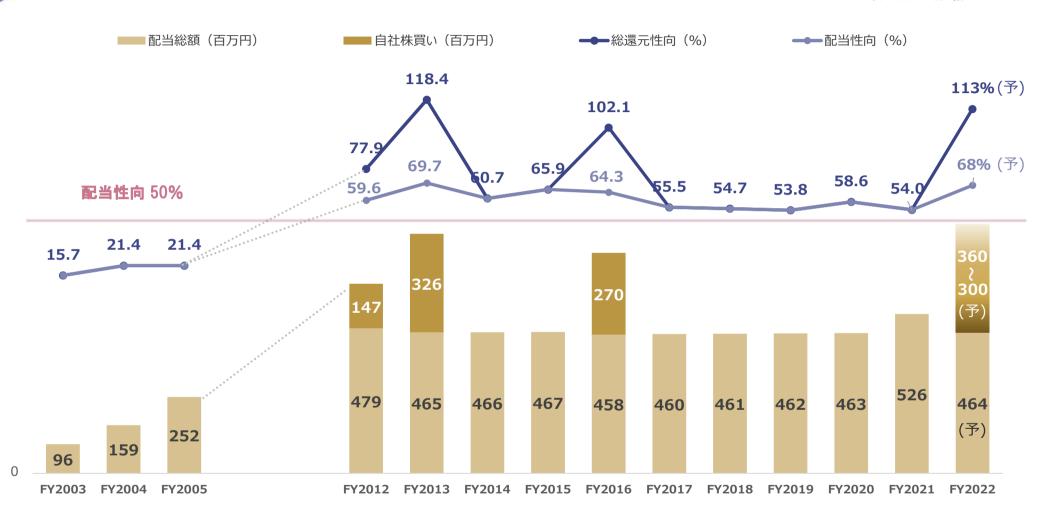
#### 消却の内容

- (1)消却対象株式の種類......当社普通株式
- (3) 消却予定日......2022年11月30日



#### 配当性向・総還元性向の推移



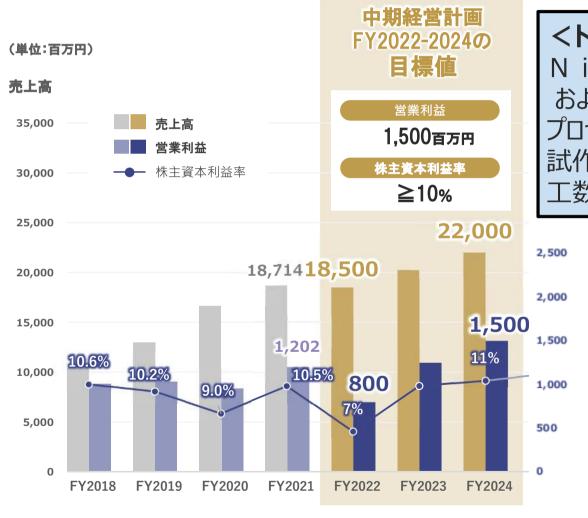


- 長期的な成長と財務健全性のバランスを取る
- ●業績及び将来の事業展開と経営基盤強化に必要な内部留保資金等を総合的に勘案して 継続して安定した配当を目指す

# 中期経

#### 中期経営計画について

#### 既存分野の新規開拓を主軸として継続した営業利益の拡大を目指す 2023年度は市況回復により21年度を上回る営業利益を計画



#### <トピックス>

N i 不使用のD I G(C u 上ダイレクトA u) および E P I G(C u 上ダイレクト P d / A u) プロセスは、デバイスメーカーとの協力による 試作テストを通して、高周波特性、実装信頼性、 工数削減効果を検証中

#### <株主資本利益率の採用に関する補足>

当社は経営指標の設定に際し、株主還元の視点から剰余金の分配可能額を重視しており、当社が目標とすべきROEとしては、自己資本利益率ではなく、会計上の自己資本から有価証券評価差額金を控除した「株主資本」を分母として計算した株主資本利益率を採用しております。

<株主資本=純資産-評価·換算差額-新株予約権>

売上高に含まれる貴金属の価格変動がない前提

見 込

実績

### 補足資料: 会社紹介

#### 沿革

●1971年7月 会社設立

●1999年11月 MBOを実施

■2002年12月 JASDAQ市場に上場

●2004年3月 東京証券取引所市場第二部に上場

●2005年3月 東京証券取引所市場第一部に上場

●2019年2月 一般財団法人JPC奨学財団設立

●2020年4月 公益財団法人JPC奨学財団に認定

●2022年4月 東京証券取引所プライム市場に移行

#### 事業概要

- ●電子部品業界の発展を支える電子材料を供給するファインケミカル企業
- 事業のターゲットを貴金属めっき薬品に絞り世界シェアトップクラス
- ●変化の激しい業界にスピーディーに対応できる販売体制と技術サポート体制を構築
- ●大規模な製造プラントを必要としないファブレス企業
- ●電子部品の接続に用いる貴金属の使用量を最小限に抑える技術を提供し、資源の有効 利用に貢献

# 注意事項•免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に 関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為 替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2022年9月時点で入 手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

#### お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

https://www.netjpc.com